

中信建投证券股份有限公司

关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

2025 年半年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司	被保荐公司名称：唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司
保荐代表人姓名：秦瀚东	联系方式：0755-83237439 联系地址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心大厦 35 层
保荐代表人姓名：沈杰	联系方式：0755-88999729 联系地址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心大厦 35 层

经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）“证监许可〔2022〕425号文”批准，唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（简称“公司”或“唯捷创芯”）公开发行股票 4,008 万股，占发行后总股本的 10.02%。本次公司发行新股的发行价为 66.60 元/股，募集资金总额为 266,932.80 万元，扣除发行费用 16,681.67 万元后，实际募集资金净额为 250,251.13 万元。本次公开发行股票于 2022 年 4 月 12 日在上海证券交易所科创板上市。中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”）担任本次公开发行股票保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，由中信建投证券完成持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》，中信建投证券出具本半年度持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务。	保荐机构已与唯捷创芯签订《持续督导协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务。
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访等方式，了解唯捷创芯经营情况，对唯捷创芯开展持续督导工作。

序号	工作内容	持续督导情况
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	2025年半年度，唯捷创芯在持续督导期间未发生按有关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况。
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐机构采取的督导措施等。	2025年半年度，唯捷创芯在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项。
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	在持续督导期间，保荐机构督导唯捷创芯及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	保荐机构督促唯捷创芯依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	保荐机构对唯捷创芯建立健全并有效执行内控制度履行了督导职责，唯捷创芯的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行。
9	督导公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	保荐机构督促唯捷创芯严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。 对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	保荐机构对唯捷创芯的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行了事前审阅，不存在由于公司对存在问题的信息披露文件不予更正或补充而应向上海证券交易所报告的情况。
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关	唯捷创芯不存在控股股东及实际控制人；2025年半年度，唯捷创芯董事、监事、高级管理人员未发生该等事项。

序号	工作内容	持续督导情况
	注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。	唯捷创芯不存在控股股东及实际控制人；2025年半年度，唯捷创芯及原实际控制人不存在未履行承诺的情况。
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	2025年半年度，保荐机构持续关注公共媒体关于唯捷创芯的报道及相关市场传闻，经保荐机构核查，唯捷创芯不存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的情况。
14	发现以下情形之一的，保荐机构应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐机构持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐机构认为需要报告的其他情形。	2025年半年度，唯捷创芯未发生相关情况。
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用；（三）可能存在重大违规担保；（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（五）资金往来或者现金流存在重大异常；（六）上海证券交易所要求的其他情形。	2025年半年度，唯捷创芯不存在需要专项现场检查的情形。
16	持续关注上市公司的承诺履行情况。	2025年半年度，唯捷创芯不存在未履行承诺的情况。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

在本持续督导期间，保荐机构和保荐代表人未发现公司存在重大问题。

三、重大风险事项

在本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

（一）技术风险

1、研发失败的风险

公司新产品的研发风险主要来自以下几个方面：（1）新产品研发周期长，可能耗时半年至数年，在产品规划阶段，若公司产品定位错误，可能导致研发的新产品不适应未来市场需求的发展变化；（2）若公司对自身技术开发能力和产品开发的成功率判断失误，可能导致产品开发过程无法顺利推进，或者研发设计的产品不能成功流片、未达到预定性能等；（3）新产品上市销售阶段，若产品方案不够成熟，市场接受程度不理想，可能导致新产品销售迟滞，无法有效的收回前期研发投入的成本，影响公司的经营业绩以及后续研发工作开展。

2、产品升级迭代的风险

射频前端芯片产品主要应用于包括智能手机在内的消费电子行业，该行业具有产品迭代频繁、市场格局变动较快等特点。此外，公司产品也需要随着不断发展的通信技术进行迭代。公司需及时推出满足市场需求的新产品并保持前瞻性，以保持市场竞争力。如果公司的技术升级速度和产品迭代成果未达到预期水平，未能及时、有效满足市场需求，或出现颠覆性、革新性的新技术导致公司现有产品被替代，则存在公司产品升级迭代的风险，导致公司的行业地位和市场竞争力下降。

3、优秀研发人才流失的风险

公司专注于集成电路的设计环节。对于射频前端芯片，研发人员应具备扎实的设计理论知识，基于对材料和封装工艺的深入了解，通过复杂的电路设计实现各类性能指标的优化和均衡，完成既定研发目标。但集成电路行业整体面临较大的专业人才缺口，如果发生优秀研发人才大面积流失的情况，将对公司的研发实力、生产经营和市场竞争力产生不利影响。

4、技术秘密泄露的风险

公司的各类核心技术贯穿于公司产品的研发设计、工艺选型、封装、测试等

各个环节，是公司长时间投入各种资源积累的成果，也是公司保持产品市场竞争力的基础和保障。技术秘密的保密工作对公司维持产品及技术的竞争力尤为重要。对于未公开的非专利技术及体现研发战略的在研产品，若保密不当导致泄露，则可能严重削弱公司技术的优势和产品的竞争力。

（二）经营风险

1、营业收入无法持续高速增长，盈利水平同时受到影响的风险

公司产品主要应用于智能手机之中，智能手机行业具有竞争激烈、产品和技术更迭较快、头部品牌厂商集中且市场占有率较高的特点。公司客户或终端客户主要为知名品牌厂商，若出现智能手机行业整体出货量下降、公司与头部品牌厂商的合作关系发生变化、头部品牌厂商采用自研射频前端芯片、现有主要客户的终端市场占有率大幅下降等不利因素，或公司未能及时拓宽及迭代产品线、开拓新的应用领域以应对激烈的市场竞争，均可能导致下游行业及客户对公司产品的采购需求降低。目前由于消费电子需求未有明确的转暖信号，公司未来营业收入可能无法持续增长，或影响公司盈利水平。

2、毛利率相对较低的风险

公司主要产品为射频功率放大器模组，通过和境内外可比上市公司进行比较，公司毛利率相对较低，虽然 5G 射频功率放大器模组收入占比增加，但毛利率仍低于境内同行业上市公司和境外领先厂商。公司产品销售单价受美系和日系领先厂商同类产品的市场定价、产品及技术的先进性、客户议价能力以及过往销售价格等因素的共同影响；产品单位成本亦受原材料及封测服务的采购单价以及产业链供需关系等因素影响，亦存在一定的不确定性。若公司未能及时推出更先进的产品争取更高的利润空间、产品的竞争力不足、无法适应市场竞争导致销售价格持续下降，或未来原材料或封装测试服务产能供给紧张导致采购价格上涨，或公司在供应链中的议价能力下降，均可能导致公司无法进一步改善毛利率，对盈利能力产生不利影响。

3、客户集中度较高的风险

公司主要采用经销或直销模式向手机品牌或 ODM 厂商销售产品，下游终

端市场以及产业链特点决定了客户的集中度较高。报告期内，公司对前五大客户的营业收入合计数占收入的比例为 91.38%。公司的经营业绩与头部手机品牌厂商的经营情况相关性较高，如未来该等头部手机品牌厂商的市场份额下降或竞争地位发生重大变动，或公司与头部手机品牌厂商的合作关系发生变化，公司将面临订单减少或流失等风险，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

4、优质供应商替代性选择较少的风险

报告期内，公司向主要供应商的采购集中度较高且晶圆供应商主要为境外供应商。全球半导体产业链中，与上述原材料和封装测试服务供应商在产品质量、技术实力和供应能力方面相同或接近的替代性选择较少。若公司因供应商或公司自身业务发展考虑、集成电路产业链产能紧张、全球贸易环境的不利变化等因素而主动或被动与上述一个或多个供应商中断或终止合作，亦或其大幅提升供货价格、结算要求等，且公司难以及时转向其他合格的替代供应商，公司可能面临产品性能或质量表现下降、产能不足、原材料供应短缺从而影响经营业绩的风险。

（三）财务风险

1、应收账款回收风险

截至报告期末，公司应收账款账面价值为 27,259.01 万元，占流动资产的比例为 7.38%。然而，随着公司经营规模的持续扩大，受市场环境和客户经营情况变动等因素影响，公司应收账款余额可能逐步增加。若未来公司应收账款不能及时回收，将对公司资金使用效率和经营业绩造成不利影响。

2、汇率波动的风险

报告期内，公司存在境外销售、采购和收付外币款项情况。随着业务规模持续扩大，若国内外政治、经济环境发生变化，汇率变动将存在较大不确定性。未来，若人民币与美元汇率发生大幅波动，将对公司业绩造成一定影响。

3、政府补助减少和政策变化风险

报告期内，公司计入当期损益的政府补助金额为 1,025.68 万元。如果未来公司享受的政府补助政策取消，或政府补助政策、补助力度等发生不利调整，将对

公司经营业绩和盈利产生不利影响。

4、存货跌价风险

公司存货主要由原材料、半成品以及库存商品构成。报告期末，公司存货账面价值为 58,419.48 万元，占流动资产的比例为 15.82%。若市场需求环境发生变化，市场竞争加剧或公司不能有效拓宽销售渠道，优化库存管理，将可能导致公司产品滞销、存货积压，存货跌价风险提高，进而对公司经营业绩产生不利影响。

（四）行业风险

1、市场竞争加剧的风险

目前，全球射频前端市场主要由 Broadcom、Skyworks、Qorvo、Qualcomm 和 Murata 等美日厂商主导，且占据了国内射频前端芯片行业的高端产品市场，对国内试图进入中高端产品市场的企业造成极大的竞争压力。面对该等头部厂商的竞争压力，对于性能相似的产品，公司可能采取为客户提供更佳性价比的策略获取订单，存在因此导致产品利润水平和现金流承压的风险。此外，近年来国内企业仍在中低端领域充分竞争，以“价格战”为主要竞争策略的市场环境下，存在面临国内同业企业竞争加剧，导致公司盈利能力下降的风险。

2、行业政策波动风险

集成电路行业作为我国的重点扶持产业，长期以来受益于国家政策的支持和推动。若未来国家针对集成电路设计行业的产业政策发生调整或变化，集成电路设计行业增长势头可能因此受到不利影响，导致公司面临一定的行业政策波动风险，在市场竞争中面临不确定性和压力。

3、供应商产品和服务质量的风险

公司自设立以来以 Fabless 模式开展经营，将芯片各类原材料的制造、加工、封装、测试等环节委托外部供应商完成，这对公司的供应链管理能力和产品质量提出了较高要求。而射频功率放大器模组是耗能高、功率大的器件，在应用过程中若出现质量问题，将导致通讯设备丧失部分通讯功能。

若出现某一供应商原材料性能、质量不达标等问题，将直接影响公司最终芯

片产品的可靠性、稳定性和性能表现,可能导致终端客户产品的消费者体验不佳,损害客户品牌商誉,进而严重影响客户关系和经营业绩。

(五) 其他重大风险

1、知识产权风险

公司自设立以来,通过自主创新申请并积累了多项知识产权。然而,公司不能排除竞争对手或其他第三方利用无效专利和公知技术主张公司或上下游供应商、客户侵犯其知识产权的可能性,存在竞争对手采用恶意诉讼或其他手段发起知识产权争议或纠纷,试图直接或间接影响公司声誉、阻碍公司经营发展的风险。此外,截至 2025 年 6 月 30 日,公司拥有 40 项境外注册的专利,由于不同国家、不同法律体系对知识产权的权利范围的解释与认定存在一定差异,可能存在由此引发知识产权争议和诉讼的风险。

2、技术授权风险

公司技术和产品研发的过程中需要使用电子设计自动化软件(EDA),并取得相关 EDA 供应商的技术授权。鉴于 EDA 市场目前形成的寡头竞争格局,主要国外厂商的 EDA 工具在其细分功能领域没有可靠的替代性产品。如果 EDA 供应商取消对公司技术授权,将导致研发和生产工作无法正常开展,对公司业务和经营产生重大不利影响。

3、产品质量纠纷风险

大型品牌客户对射频功率放大器可靠性要求非常严苛。然而,导致射频功率放大器出现故障的可能因素较多,除产品自身设计、原材料质量、晶圆制造和封测质量等因素外,若其他配合使用的器件存在质量或设计问题,也可能导致射频功率放大器模组工作出现故障。基于上述,排查并确定故障原因的难度大、耗时长,公司、客户和供应商可能对产品质量责任的判断存在不一致的理解或纠纷,给公司带来法律、声誉及经济等方面不利影响。

4、公司业务模式变化的风险

集成电路生产测试项目实施后,公司将向产业链下游延伸,通过自建部分测

试生产线的方式布局集成电路测试环节，公司业务模式将从轻资产模式转向一定程度的重资产模式。公司在原来的 Fabless 模式下，自身并不具备大规模资产管理的经验，可能会因缺乏设备运营经验导致设备运营效率较低，出现产能使用不足从而降低项目实施效率，存在影响公司盈利能力的风险。

5、内控体系建设及内控制度执行的风险

公司已根据现代企业管理的要求，逐步建立健全了符合科创板上市公司要求的内部控制体系，但上述制度及体系的实施时间较短，且仍需根据公司业务的发展、内外环境的变化不断予以修正及完善。若公司因内控体系不能及时完善，或有关内部控制制度不能有效实施，将直接影响公司生产经营活动的合规性以及运作效率，进而影响公司经营管理目标的实现。

6、宏观环境风险

近年来，国际贸易摩擦不断升级。鉴于集成电路产业系全球产业链高度分工化合作的行业，产业链在国际贸易摩擦中均不可避免受到一定程度的负面影响。作为集成电路设计企业，公司及公司现有供应商大部分都不同程度地使用了国外的设备或技术，若贸易摩擦进一步加剧，公司的研发设计以及产品供应都可能受到影响。

四、重大违规事项

在本持续督导期间，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2025 年半年度，公司主要财务数据如下所示：

单位：万元

主要会计数据	2025 年 1-6 月	上年同期	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	98,666.54	107,159.57	-7.93
利润总额	-2,134.97	2,003.13	-206.58
归属于上市公司股东的净利润	-943.36	1,126.86	-183.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,042.53	-1,162.99	不适用

主要会计数据	2025年1-6月	上年同期	本期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	45,695.04	-20,772.29	不适用
主要会计数据	本报告期末	上年度末	本期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	395,057.46	399,201.01	-1.04
总资产	441,161.26	458,997.19	-3.89

公司主要财务指标如下表所示：

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.03	-166.67
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.03	-166.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.03	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.23	0.28	减少0.51个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.51	-0.29	减少0.22个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	20.55	20.73	减少0.18个百分点

2025年1-6月，公司主要财务数据及指标变动的的原因如下：

1、2025年1-6月，公司实现营业收入98,666.54万元，较上年同期降低7.93%；归属于上市公司股东的净利润为-943.36万元，较上年同期降低183.72%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,042.53万元，较上年同期减少879.54万元。业绩同比下滑主要系射频前端芯片市场竞争态势加剧，公司部分产品面临价格下行的压力，从而压缩了产品的利润空间。面对盈利下滑的挑战，公司积极优化产品结构，高毛利率产品占比增加，2025年第二季度公司整体毛利率较第一季度增加6.75个百分点至28.02%。

2、2025年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额为45,695.04万元，较上年同期转负为正，同比增加66,467.33万元，主要系公司库存持续消耗，报告期内购买商品所支付的现金减少所致。

3、2025年1-6月，公司基本每股收益较上年同期降低166.67%；稀释每股收益较上年同期降低166.67%；加权平均净资产收益率较上年同期减少0.51个百分点。主要系本报告期净利润同比减少所致。

六、核心竞争力的变化情况

（一）核心竞争力分析

自创立以来，公司始终以创新的设计和卓越的技术实力，致力于成为行业的领导者，专注于射频前端芯片的研发与产业化应用，坚定地将研发投入与技术创新置于公司发展的核心位置。

1、技术创新与研发实力：公司发展的根本动力

战略驱动与持续投入：自公司成立以来，研发创新一直是战略发展的核心驱动力。我们积极投入资源，致力于提升核心竞争力，并通过不断的自主创新和技术研发，逐步确立了行业内的技术领先地位。公司密切关注行业技术的发展、演变趋势和需求变化，加速产品线布局，积极探索未来发展方向，确保技术持续领先。公司坚持以射频前端产品线为发展中心，通过融合创新技术和先进工艺，持续推动技术研发，快速适应通信技术的变革，显著增强产品的市场竞争力。2025年，公司新的研发中心已开始建设，未来将集中投资于高集成度模组、Wi-Fi 模组等方向。

研发团队与成果：公司的核心竞争力源自于卓越的人才团队和强大的研发实力。公司高度重视人才的发掘与培养，建立了成熟的射频器件及模组研发设计团队，核心成员拥有多年的设计、开发及工艺调试经验。通过积极的人才引进策略和股权激励机制，公司吸引了国内外高层次技术人才，形成了稳固的人才梯队，为持续创新和市场拓展提供了坚实的基础。公司研发团队由 291 名专业人才组成，占员工总数的 49.16%，团队成员在射频功率放大器等关键技术领域积累了深厚的技术底蕴。公司及子公司共拥有国内发明专利 83 项、实用新型专利 84 项、集成电路布图设计登记 154 项，这些成果不仅彰显了公司在研发创新方面的实力，也体现了技术与发展战略的领先优势。这些优势共同构成了公司推动射频前端产品线不断丰富和进入更多应用市场的核心竞争力。

技术领先优势：在国内高集成度模组的研发领域，公司率先取得了突破性进展，为下一代模组方案的研发赢得了先发优势。随着 5G 技术的不断演进和新一代通信技术的逐步成熟，公司已正式推出第二代 L-PAMiD 模组（Phase 7LE Plus 模组），其在效率、功耗等关键性能上实现了相对上一代产品的显著提升，将适配主流平台厂商的新一代旗舰平台，目标市场为今年秋季的品牌手机旗舰机型。

同时，下一代高集成度模组 Phase 8L 也已正式批量出货，标志着公司在下一代产品的研发上占据了明显的先发优势。此外，公司已率先推出适配 AI 端侧的大功率 Wi-Fi 模组和蓝牙模组；车规级产品的推广也在顺利开展中，并通过对客户需求分析，努力将产品推广至机器人领域。通过持续的技术创新和对市场动态的敏锐洞察，公司将确保推出的产品和服务始终处于行业前沿，满足客户对高性能通信技术的需求，并在竞争激烈的市场中保持领先地位。

2、产品优势：创新解决方案与测试能力

一站式解决方案：公司凭借在射频前端领域的深厚积累和持续创新，构建了丰富的产品系列，这些产品广泛应用于智能手机、平板电脑、汽车电子、蓝牙耳机、无人机、AI/AR 眼镜、机器人等多个市场。公司的产品线涵盖了从分立器件到射频模组的多样化解决方案，包括 TxM、MMMBPA、L-PAMiF、L-PAMiD、L-FEM、LNA Bank、DiFEM、L-DiFEM、卫星通信、Wi-Fi、蓝牙等模组产品，全面满足客户在射频前端的多样化需求。公司以一站式服务为核心优势，为客户提供从 2G 至 5G 的全面射频前端解决方案，简化了产品导入流程，有效降低了客户的供应链管理成本与风险。通过技术研发和产品迭代，提升产品的差异化水平，加快市场响应速度，赢得了终端客户的广泛青睐。这些优势不仅展现了公司在射频前端领域的技术和实力，也为盈利能力提升和可持续发展奠定了坚实的基础，巩固了在行业中的领导地位。

产品结构升级：公司在射频前端领域的战略转型已取得显著成效，成功从中集成度模组向高集成度模组转型，并以技术领先者的身份，率先研发并推出大功率模组、Phase 8L 模组等新一代产品，在市场中形成竞争优势。公司的 5G 射频功率放大器模组以其卓越的性能和优化的能效，在市场中获得了广泛认可，并应用于多个知名终端客户的产品中。产品线的升级使公司能够覆盖高端市场和高性价比市场的全方位需求，高端市场的突破为公司带来了更广阔的市场空间和新的营收增长点，进一步提升了公司的盈利能力，这正是公司核心竞争力的重要体现。公司致力于持续创新和优化产品结构，满足不同细分市场的需求，确保公司在射频前端领域的领先地位。

自有测试优势：公司凭借自主研发的测试工具和解决方案，在射频前端领域

确立了显著的竞争优势。这些工具不仅加速了产品从设计到市场的转化，提升了测试的精准度和效率，还确保了产品品质的稳定性与可靠性。当外部测试资源紧张时，公司内部的测试能力保证了高集成度模组产品的及时测试与上市，使公司能够抓住行业发展的每一个机遇。这种自主可控的测试能力，结合对测试技术的深入理解和创新应用，使公司能够持续提供高质量的射频前端解决方案，满足市场对高性能、高可靠性产品持续增长的需求，增强了市场竞争力。

3、市场响应与未来趋势预判：研发创新和客户需求的协同优势

客户需求导向：公司坚持以客户需求为导向，通过构建完善的销售服务体系，并与研发紧密结合，实现市场与研发的高效协同。通过升级研发体系，确保产品设计的系统性和科学性，从而保证产品的高性能和高品质。这种策略加快了产品上市速度，提高了市场响应能力。公司将客户的高标准作为自我提升的动力，持续提升技术实力和服务质量，为客户提供精准高效的服务。完善的客户服务体系和一体化产品开发流程，确保了对客户需求的快速响应和精准交付，赢得了客户的信任，为维护公司的持续发展和行业领先地位提供了坚实保障。

内部管理与外部协同：公司打造并实施高标准的质量管理体系，旨在匹配品牌客户的严格要求，确保产品从设计到生产的每一个环节均符合品牌客户的高标准，保障了产品的卓越可靠性。通过与全球顶级供应商建立的稳固合作关系，公司确保了原材料质量和供应稳定性，为产品生产的连续性和可靠性打下了坚实基础。凭借大量订单形成的规模优势，公司在合作中拥有了更强的议价能力，有效降低了生产成本。同时，公司通过引入新的供应商，优化供应链管理，增加了成本控制的灵活性。此外，公司通过资源整合和供应链合作标准化，实现了供应链各环节的无缝衔接，提高了运营效率和产品质量。这些措施不仅保障了产品的长期稳定交付，也通过长期产能规划和自购核心设备等策略，减少了行业产能波动对公司供货周期的影响。

未来趋势预判与战略布局：公司始终紧密关注下游客户和终端消费者的需求，积极预判未来技术趋势并提前战略布局。例如，公司提前研发了 Wi-Fi 7 技术，成功推出相关产品，满足了市场对高速无线网络的需求；率先完成车规级产品的研发，成为国内首批通过车规级射频前端产品认证的企业，在汽车行业进行通信

装置升级的初期就参与其中；还率先研发了大功率 Wi-Fi 模组 和蓝牙模组，为 AI 终端设备提供高性能通信解决方案。这些前瞻性的研发投入和战略布局，确保公司推出的产品和服务始终处于行业前沿，为客户提供更先进、更可靠的射频前端解决方案。

（二）核心竞争力变化情况

2025 年半年度，公司的核心竞争力未发生重大不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

为了保证公司能够不断进行技术创新，保持产品和服务的技术领先水平，维持公司的市场竞争优势，公司进行持续性的研发投入。2025 年半年度，公司研发投入具体情况如下：

单位：万元

项目	本期数	上年同期数	变化幅度（%）
费用化研发投入	20,272.14	22,216.46	-8.75
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	20,272.14	22,216.46	-8.75
研发投入总额占营业收入比例（%）	20.55	20.73	减少 0.18 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	-

2025 年半年度，公司主要在研项目进展顺利，取得一定的研发成果。2025 年半年度，公司新获授权专利 23 项，其中发明专利 4 项，实用新型专利 19 项。截至 2025 年 6 月 30 日，公司通过自主研发取得专利 169 项，集成电路布图设计 154 项，软件著作权 17 项，形成了大量拥有自主知识产权的核心技术。研发成果具体情况如下：

项目	本期新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	18	4	229	83
实用新型专利	8	19	105	84
外观设计专利	0	0	2	2
软件著作权	0	0	18	17
其他	0	9	154	154
合计	26	32	508	340

注：“其他”代指集成电路布图设计。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：元

项目	期末余额
募集资金专户收到的募集资金净额	2,523,514,960.00
减：截至 2024 年末募集资金专户累计支出金额	1,985,933,395.89
截至 2024 年末募集资金专户余额	537,581,564.11
加：2025 年 6 月 30 日专户利息收入	1,468,938.31
2025 年 6 月 30 日现金管理类产品投资收益	15,252,097.20
现金管理类产品到期赎回	920,000,000.00
减：购买现金管理类产品	1,226,875,277.78
直接投入募集资金投资项目的资金	179,861,564.61
支付专户手续费支出等	15.00
集成电路生产测试项目变更结息资金	235,950.69
研发中心建设项目结项节余资金	4,002,307.91
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额	63,327,483.63

公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

唯捷创芯无控股股东及实际控制人。截至 2025 年 6 月 30 日，唯捷创芯董事、监事和高级管理人员持有公司股份的情况如下：

姓名/名称	类别	直接持股数量（股）	间接持股数量（股）	合计持股数量（股）	合计持股比例（%）
荣秀丽	董事长	53,265,280	6,556	53,271,836	12.38
孙亦军	董事、总经理	14,716,061	7,040,548	21,756,609	5.06
辛静	董事、财务负责人	1,311,283	5,217,574	6,528,857	1.52
周颖	董事	1,966,925	5,283,144	7,250,069	1.68
钟英俊	董事	-	-	-	-
许家硕	董事	-	-	-	-
蔡秉宪	董事	-	-	-	-
王成	独立董事	-	-	-	-
杨丹	独立董事	-	-	-	-
张恕恕	独立董事	-	-	-	-
黄吉	独立董事	-	-	-	-
李爱华	监事会主席	-	65,565	65,565	0.02
刘艳虹	监事	-	-	-	-
张英娇	职工代表监事	-	32,782	32,782	0.01
赵焰萍	董事会秘书	1,311,283	4,134,578	5,445,861	1.27

公司部分董事、部分监事、高级管理人员通过中信建投唯捷创芯 1 号科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“唯捷创芯 1 号资管计划”）、中信建投唯捷创芯 2 号科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“唯捷创芯 2 号资管计划”）间接持有公司股份。前述资管计划持有公司股份的限售期为 12 个月，限售期自公司在上海证券交易所科创板上市之日起开始计算。

2025 年半年度，唯捷创芯 1 号资管计划减持 2,907 股，唯捷创芯 2 号资管计划减持 15,563 股；截至 2025 年 6 月 30 日，唯捷创芯 1 号资管计划持有公司 485,458 股股份，唯捷创芯 2 号资管计划持有公司 235,613 股股份，公司部分董事、监事及高级管理人员持有资管计划份额情况如下：

姓名	职务	参与资管计划名称	持有资管计划份额比例	2025 年半年度持有份额是否发生变化
孙亦军	董事、总经理	唯捷创芯 1 号资管计划	3.03%	否
辛静	董事、财务负责人	唯捷创芯 1 号资管计划	3.03%	否
周颖	董事	唯捷创芯 1 号资管计划	3.03%	否
李爱华	监事会主席	唯捷创芯 1 号资管计划	3.03%	否

		管计划		
张英娇	职工代表监事	唯捷创芯 2 号资 管计划	6.25%	否
赵焰萍	董事会秘书	唯捷创芯 1 号资 管计划	-	否

除上述情况外，截至 2025 年 6 月 30 日，公司董事、监事和高级管理人员持有公司的股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本半年度持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名： 秦瀚东
秦瀚东

沈杰
沈杰

